

第 34 回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2021 年 7 月 16 日（金）13:00～17:00
オンライン開催

プログラム

12:45～受付開始

司会 渡邊 裕彦（富士電機(株)）

13:00～13:40 「車載用高密度実装部品の信頼性解析とばらつき評価」（40 分）

○于 強（横浜国立大学）

13:40～13:50 休 憩

13:50～14:30 「繰返し通電試験におけるはんだ接合部寿命を簡易に予測する手法」（40 分）

○河村 祐貴（三菱電機(株)）

14:30～14:40 休 憩

司会 山内 啓（群馬工業高等専門学校）

14:40～15:20 「実装分野に貢献するディスプレイ技術のご紹介」（40 分）

○上久保 尚（武蔵エンジニアリング(株)）

15:20～15:30 休 憩

15:30～16:10 「微細はんだ接合部 FEA の高精度化に向けた
Cu/Sn 系 IMCs の引張特性評価」（40 分）

○黒沢 憲吾（秋田県産業技術センター）

16:10～16:20 休 憩

16:20～16:50 「低融点はんだの接合信頼性向上に向けた取り組み」（30 分）

○井上 剣太（千住金属工業(株)）

16:50～17:00 委員会議事

（ ） 内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。
※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会